

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2025-039

通富微电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2. 报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务情况

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞

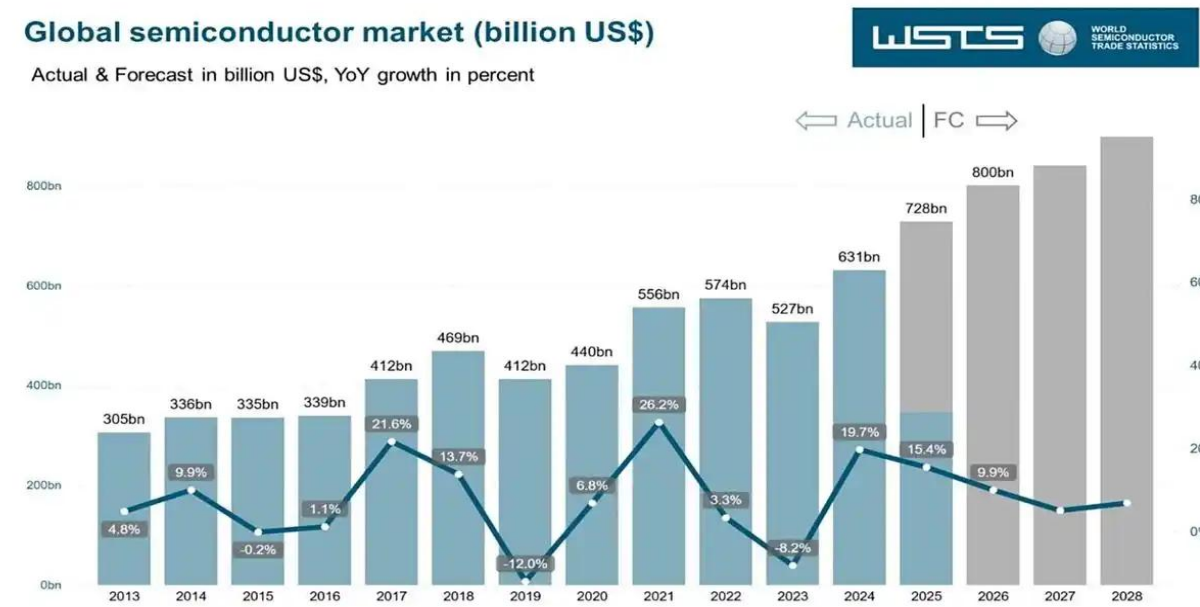
争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

（二）公司所处行业情况

1. 2025 年上半年半导体市场情况

2025 年上半年，全球半导体市场在人工智能、汽车电子等各大领域的需求驱动下呈现结构性增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布，今年上半年，全球半导体市场规模达 3,460 亿美元，同比增长 18.9%。同时，其对 2025 全年世界半导体市场规模的预测上调至 7,280 亿美元，较 2024 年提升 15.4%；而 2026 年半导体市场规模则有望达到 8,000 亿美元，进一步同比增长 9.9%。从国内情况来看，出口端的数据同样印证着产业的快速发展。据海关总署统计，上半年我国集成电路出口额为 904.7 亿美元，同比增长 18.9%，出口数量 1,677.7 亿块，同比增长 20.6%，出口量值均为同期新高。6 月当月，我国集成电路出口额同比增长 24.4%至 172.2 亿美元，已连续 20 个月实现同比增长；出口量同比增长 25.8%至 318.4 亿块，出口量值同创月度新高。

图表：2013-2028 年全球半导体市场规模及预测（单位：十亿美元）



来源：IT 之家、WSTS

半导体市场的持续增长是多种因素共同作用的结果。技术的不断革新，让半导体元件的性能得以不断优化，能够满足新兴领域对芯片算力、功耗、尺寸等方面的严苛要求。从市场需求端来看，智能汽车、工业 4.0 以及消费电子领域的创新发展，为半导体创造了广阔的市场空间。在国家政策的大力扶持下，国内企业更加坚定地走自主研发之路，加大研发投入，提升产业自主可控能力。

具体从下游领域来看：

AI 手机、AI 电脑、AI 眼镜正在成为年轻人的潮流三件套。据商务部最新数据显示，今年以来，超 6,900 万消费者购买手机等数码产品超 7,400 万件。其中尤以智能眼镜市场的爆发最为突出，其品类成交量同比激增 10 倍，电商平台的入驻品牌数量较去年增长超 3 倍。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示今年上半年，我国生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步，产品数量迅猛增长，应用场景持续扩大。截至今年 6 月，用户利用生成式人工智能产品回答问题的比例最高达 80.9%。国产人工智能产品不仅在千亿级参数规模、多模态能力等方面实现突破，并与办公协同、教育普惠、工业设计、内容创作等场景深度融合，构建了覆盖多个领域的智能应用生态。汽车领域也迎来了黄金发展期，2025 年全球汽车芯片市场规模预计达 804 亿美元，中国占 216 亿美元，单车芯片用量从传统燃油车的 934 颗增至智能电动车的 2072 颗。展望 2025 年下半年，需求持续增长的 AI 和新能源汽车等新兴领域依旧是关键驱动力。

2. 行业相关政策

2025 年上半年，国家出台了一系列政策支持半导体集成电路产业发展。2025 年 6 月 27 日国常会强调，需以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强；围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权；要切实将科技成果转化转化为现实生产力，充分发挥我国超大规模市场优势，强化企业科技创新主体地位，深化科技成果转化机制改革，推动科技创新和产业创新深度融合。

2025 年 1 月人力资源社会保障部等 8 部门出台《关于推动技能强企工作的指导意见》，支持企业数字人才培育，聚焦大数据、人工智能、智能制造、集成电路、数据安全等领域，挖掘培育新的数字职业序列。中国半导体产业在政策引导、市场需求与技术创新三重动力下，正加速构建自主可控的技术生态体系。

地方层面，深圳市出台《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，并设立总规模 50 亿元的“赛米产业私募基金”，以“政策+资本”组合拳，支持产业全链条优化提质。《若干措施》围绕“强链、稳链、补链”核心目标，从高端芯片产品突破、加强芯片设计流片支持、加快 EDA 工具推广应用、突破核心设备及配套零部件、突破关键制造封装材料、提升高端封装测试水平、加速化合物半导体成熟等方面提出 10 条具体支持举措。

（三）报告期公司经营情况

1、抓住行业复苏势头，实现业务多元化增长

2025 年上半年，全球半导体市场呈现“技术驱动增长、区域分化加剧”特征。AI 芯片与存储芯片成为核心增长点，美洲市场增速 25%领跑全球，中国及亚太地区受益于 AI 终端渗透率突破 18%，贡献全球 35%增量需求。

上半年，随着手机芯片、汽车芯片国产化进程加快，家电等国补政策持续利好，公司紧抓机遇，在手机、家电、车载等众多应用领域提升公司市场份额，在 WiFi、蓝牙、MiniLED 电视显示驱动等消费电子热点领域，成为多家重要客户的战略合作伙伴；同时夯实与手机终端 SOC 客户合作基础，份额不断提升；依托工控与车规领域的技术优势，加速全球化布局，提升整体市场份额。

上半年，公司大客户 AMD 的业绩延续了增长势头，其数据中心、客户端与游戏业务表现突出，通过产品迭代和市场扩展实现了营收与利润的双增长。其中，AMD 数据中心业务持续增长，主要源于 EPYC CPU 的强劲需求；AMD 客户端业务营业额创季度新高，第二季度达 25 亿美元，同比增长 67%，主要得益于最新“Zen 5”架构的 AMD 锐龙台式处理器及更丰富的产品组合的强劲需求；AMD 游戏业务显著复苏，第二季度营收 11 亿美元，同比增长 73%，增长动力来自游戏主机定制芯片和游戏 GPU 需求的增加。大客户 AMD 业务强劲增长，为公司的营收规模提供了有力保障。2025 年上半年，通富超威苏州和通富超威槟城继续深度融合，优化资源，通过不断的对标及改善，在质量管理体系建设，人才梯队培养，产品产能提升等方面都取得了卓越的成绩。同时，两家工厂充分结合市场策略，聚焦 AI 及高算力产品、车载智驾芯片的增量需求，积极扩充产能，拓展新客户资源，成功导入多家新客户。

得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，2025 年上半年，公司实现营业收入 130.38 亿元，同比增长 17.67%；公司归属于上市公司股东的净利润 4.12 亿元，同比增长 27.72%。

在全球半导体产业格局错综复杂、动态变化的当下，公司凭借着突出的技术创新实力、过硬的产品品质与专业的客户服务体系，赢得了市场的广泛认可。公司目前已成为多家客户本土化生产的首选合作伙伴。公司将从全方位、多维度进行助力，帮助客户实现技术重大突破与产品迭代升级，携手探索并拓展更为广阔的市场疆域。

展望 2025 年下半年，业界分析认为，需求持续增长的 AI 和新能源汽车等新兴领域依旧是关键驱动力。存储、通信、汽车、工业等主要领域的需求逐步复苏。在技术驱动的新一轮上行周期与应用市场逐步复苏的叠加影响下，整体封测市场发展向好。未来，随着 5G、AIoT、智能汽车等新兴应用的普及，对封装技术提出了更高要求。中国封测企业需要在高密度集成、低功耗设计、高散热性能等关键技术领域持续突破，同时加强与国际先进企业的合作交流，共同推动封装技术的创新发展。在政策支持、市场需求和技术进步的多重驱动下，中国 IC 封测行业有望实现从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的历史性跨越。

2、公司技术研发水平不断精进

2025 年上半年，公司在大尺寸 FCBGA 开发方面取得重要进展，其中大尺寸 FCBGA 已开发进入量产阶段，超大尺寸 FCBGA 已预研完成并进入正式工程考核阶段；同时，公司通过产品结构优化、材料选型及工艺优化，解决了超大尺寸下的产品翘曲问题、产品散热问题。此外，公司在光电合封（CPO）领域的技术研发取得突破性进展，相关产品已通过初步可靠性测试。

在 Power 产品方面，公司的 Power DFN-clip source down 双面散热产品已研发完成，能够满足产品大电流、低功耗、高散热及高可靠性的要求。在传统打线类封装产品技术开发方面，通过传统圆片正反面镀铜的方式，来实现封装产品高散热、低功耗等性能提升。上半年针对 Cu wafer 封装的需要，研发建立了相关的工艺平台，完成了相关工艺技术升级，解决了 Cu wafer 在切割、装片、打线等封装工艺方面的技术难题。目前已在成功在 Power DFN 全系列上实现大批量生产。

公司秉持创新驱动发展战略，深耕技术研发与自主创新。截至 2025 年 6 月 30 日，集团累计专利申请量突破 1,700 件，其中发明专利占比近 70%；累计授权专利超 800 项，形成了涵盖传统封装和先进封装的全方位知识产权保护网络，为公司高质量发展注入创新动能。

3、重大工程建设稳步推进，保障发展空间

2025 年上半年，公司围绕战略发展目标，持续推进多项项目建设，为产能提升和技术升级奠定坚实基础。南通通富 2D+先进封装技术升级和产能提升项目的机电安装工程顺利通过消防备案，为后续投产运营提供了有力保障；通富通科新建 110KV 变电站项目稳步推进，建成后将显著增强通富通科的电力供应能力，支撑公司的长期发展需求；通富通科集成电路测试中心项目规划改造有序开展，改造面积约 2.3 万平方米，将进一步优化产能布局、增强公司的技术实力。公司重大项目建设持续稳步推进，确保满足当前及未来的生产运营需求，为企业高质量发展注入强劲动力。

4、深化组织与人才创新，打造面向未来的高韧性发展新优势

在全球集成电路封装测试行业竞争持续深化、技术变革加速的背景下，公司进一步强化“科技引领未来，人才驱动发展”的战略核心，以组织敏捷化、人才专业化、机制长效化为抓手，持续优化面向未来的组织与人才生态体系。

（1）敏捷高效的协同组织建设

坚持组织建设与业务发展相匹配，面对多地区、多业务的发展格局，建设敏捷高效的协同组织，持续优化组织阵型，加强学习型组织建设，倡导“敬天爱人”组织文化，通过打造“六边形组织”、“TFT 组织”等，夯实组织运作。在战略关键点开展系统会战，打破组织边界，缩短管理链条，加强跨部门的紧密协同，快速满足客户需求，实现业务领先。

（2）梯队化人才队伍打造

公司深刻认识到，构建结构合理、层次分明的人才梯队，是驱动持续创新的关键动力源。基于这一核心认知，公司持续强化人才梯队的系统化建设，不仅面向社会招募经验丰富的行业精英，更积极通过优化校园招聘、深化校企合作等方式，精准发掘和吸纳具有创新潜力的新生力量，确保人才来源的多样化和梯队结构的完整性，为公司发展注入强大且可持续的创新动能。

（3）领导力深化与技术人员赋能

公司持续完善领导力发展体系，通过引入张謇学院等领导力培养项目，并结合“导师制”一对一辅导机制，加速新晋干部成长。同时，公司基于“六边形人才标准”和工程技术人员能力等级体系，构建了多层次人才培养框架，既强化了干部队伍的领导力，又夯实了技术人才的专业基础，为构建新质生产力和实现高质量发展提供双重人才保障。

（4）长效激励机制建设

公司持续深化“责任结果导向”的激励理念，进一步完善差异化、多维度的激励机制，精准匹配各业务线战略目标与发展阶段。通过优化短期与长期激励相结合的模式，强化核心人才绑定，激发全员创新活力；同时，围绕员工成长需求，升级关怀体系，从职业发展、健康管理、工作环境等多维度提升员工体验，实现“价值创造—成果共享”的良性循环，为公司可持续发展注入持久动力。

展望未来，公司将继续深化数字化转型赋能组织效能、强化领导梯队战略视野与创新力、完善高潜人才全周期培养机制、升级多元化激励体系，逐步实现人力资源与业务战略的深度协同，为高质量发展提供坚实的人才保障和组织动能。

3、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	13,038,246,156.27	11,080,086,982.96	17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	412,092,154.12	322,663,289.17	27.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	420,437,486.81	316,478,415.93	32.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,480,182,511.26	1,844,455,652.90	34.47%
基本每股收益（元/股）	0.2715	0.2130	27.46%
稀释每股收益（元/股）	0.2715	0.2130	27.46%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.29%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	41,844,268,125.01	39,340,187,388.18	6.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,751,352,045.02	14,690,833,021.88	0.41%

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		276, 026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19. 90%	301, 941, 893	0	质押	43, 810, 000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7. 77%	117, 980, 609	0	不适用	0
苏州园丰资本管理有限公司－苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	2. 95%	44, 772, 619	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1. 65%	25, 073, 903	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1. 35%	20, 519, 835	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1. 30%	19, 663, 244	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1. 19%	18, 022, 677	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0. 85%	12, 877, 541	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0. 59%	9, 029, 350	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0. 48%	7, 307, 260	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
--------------------	-----

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

无

通富微电子股份有限公司
董事长： 石磊
2025 年 8 月 27 日